

2016 年 10 月 19 日
三菱電機株式会社

NEWS RELEASE

さらに高い生産性と加工位置精度を実現 三菱基板穴あけ用レーザー加工機「GTW5 シリーズ」発売のお知らせ

三菱電機株式会社は、基板穴あけ用レーザー加工機の新製品として、さらに高い生産性と加工位置精度を実現した「GTW5 シリーズ」を 10 月 19 日に発売します。

本製品は、「TPCA Show 2016」(10 月 26 日～28 日、於：台北南港展覽館)に出展します。



三菱基板穴あけ用レーザー加工機「ML605GTW5-5350U」

新製品の特長

1. Synchrom テクノロジーと新ガルバノスキャナーにより、生産性を向上

- ・当社独自の Synchrom (シンクローム) テクノロジーにより、加工テーブルの移動とレーザー加工を同時に行い非加工時間を従来比約 50%短縮※1
- ・さらに、位置決め速度を向上した新ガルバノスキャナー※2により、マザーボード基板※3の加工時間を従来比約 20%短縮※1

※1 従来機 GTW4 シリーズとの比較 (加工内容、加工材料などによって異なります)

※2 ミラーを高速で駆動し、レーザー光を位置決めする装置

※3 CPU やメモリーなどの電子部品を搭載する電子回路基板

2. 新ガルバノスキャナーと新プラットフォームにより高い加工位置精度を実現

- ・位置決め速度の向上と高剛性化を実現したガルバノスキャナーと、加工中の加減速による機械変形を抑制した新構造プラットフォームにより、加工位置精度を従来比約 10%改善※1

発売の概要

製品名	形名	発売日	月産台数
基板穴あけ用 レーザー加工機	ML605GTW5-5350U	10 月 19 日	50 台
	ML706GTW5-5350U		

発売の狙い

スマートフォンやタブレット PC などの電子機器のさらなる高機能化と高密度化に対応するため、製造現場においては小型電子機器用のマザーボード基板や半導体パッケージ基板への微細穴あけ用途として、レーザー加工の需要が拡大しています。一方、レーザー加工機に対しては、基板製造工程のコストダウンのための加工時間の短縮と、基板の小型・高機能化の実現に向け、高い加工位置精度が求められています。

当社は今回、これらの要求に応えるため、当社独自の制御技術である **Synchrom** テクノロジーと新ガルバノスキャナー・新プラットフォームの採用により、さらに高い生産性と加工位置精度を実現した基板穴あけ用レーザー加工機「GTW5 シリーズ」を発売します。

主な仕様

項目			仕様	
システム	形名		ML605GTW5-5350U	ML706GTW5-5350U
	外形寸法 (mm) ※4		4780W×3370D× 2270H	5000W×3420D× 2270H
	機器質量 (kg) ※4		9000	9100
加工機	XY テーブル	加工ワーク寸法 (mm)	620×560	815×662
		最大送り速度 (m/min)	50	50
発振器	レーザーの種類		CO ₂ レーザー	CO ₂ レーザー
	出力 (W)		360	360
	設定周波数 (Hz)		10～10000	10～10000

※4 加工機・発振器・制御装置・冷却装置・ワーク吸着装置・基板搬送装置(オプション)を含めた寸法・質量
基板搬送装置の仕様によって寸法・質量は異なります

製品担当

三菱電機株式会社 名古屋製作所
〒461-8670 愛知県名古屋市東区矢田南五丁目 1 番 14 号
TEL 052-712-2209 FAX 052-712-3483

お客様からのお問い合わせ先

三菱電機株式会社 産業メカトロニクス事業部
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号
TEL 03-3218-6540 FAX 03-3218-6822